

PRESSE-NEWS

## **Die Drei auf der Baugruppe: THT, SMD und Bonding - beflex in Windisch fertigt komplett in Eigenregie**

**Frickenhausen, 03. November 2015**

Das Schweizer Technologiewesen lebt vom Anspruch höchster Fertigung und Qualität. Wer sich hier wettbewerbsgerecht aufzustellen vermag, findet Zuspruch im Markt. Was bislang bei der beflex electronic in Windisch schon gang und gäbe war, das hausinterne hochqualifizierte Bestücken im THT- und SMD-Verfahren, erfuhr nun ein weiteres Service-Debüt: Mit einem Prototyping-Projekt für ein namhaftes schweizerisches Technologieunternehmen ging man ans Bonden. Dabei erwies sich die Aufgabe als hochkomplex, eine Herausforderung an höchste Präzision.

Auf Stabilität und durchgängig gesicherte Prozessstabilität bedacht, ging man daran, eine komplexe Starr-Flex-Leiterplatte mit einem äußerst breiten Bauteil-Mix zu bestücken. Es galt, BGAs, Stecker, Flip-Chip-Komponenten und 0201er-Elemente geschickt und auf äußerste Sauberkeit bedacht, zu platzieren. Das technische Nadelöhr lag in der Bedingung, die Baugruppe, in verschiedenen Positionen gelagert so zusammenzulegen, dass sie der Kunde noch mühelos bei hoher Packungsdichte in das vorgegebene Gehäuse bekommt. Ein innovatives Produkt, das fachlich schweisstreibend fordert. So kam, bei der Bauteildichte auf kleinstem Raum, das Bonden mit ins Spiel – die Sicherheit für direkte Übertragung, für eine äußerst kurze Signaldistanz. In diesem Fall wurde ein Silizium-Die mit der Leiterplatte verklebt und ausgehärtet, mit einem Spezialkleber aufgebracht. Im Anschluss verband man den Die auf der Leiterplatte per 20µm Gold-Draht-Bondverfahren. Für die mechanische Sicherheit des Die sorgte dann die Glop-Top-Versiegelung zum Schluss.

Das Ergebnis: ein perfektes Zusammenspiel aller Produktionsprozesse für ein für den Kunden wichtiges, innovatives Produkt. Rückblickend betrachtet, kam die frühzeitige Einbindung in das Projekt, der geforderten zügigen Erarbeitung des Prototyps in Bezug auf Zeiteinsparung sehr zugute.

**BILDUNTERSCHRIFT / Wenn's eng wird beim Packaging:** Auch akute Platznot und kurze Signalwege sind gut in den Griff zu kriegen, wenn man bei der Bestückung das Bonden mit einbeziehen kann.

Weitere Informationen über die beflex electronic finden Sie hier:

<http://www.beflex.de>

**Pressekontakt:**

Claudia Palozzo c/o IMA-Institut Hamburg

Hagedornstrasse 18, D - 20149 Hamburg

+49 (0) 40 30 96 96-0 [c.palozzo@ima-gination.de](mailto:c.palozzo@ima-gination.de)

[www.ima-gination.de](http://www.ima-gination.de)